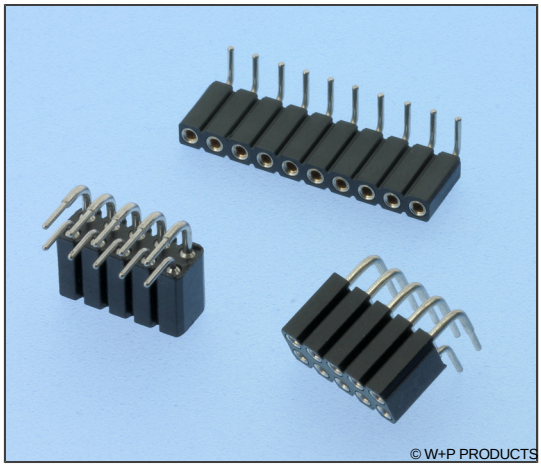
# 154

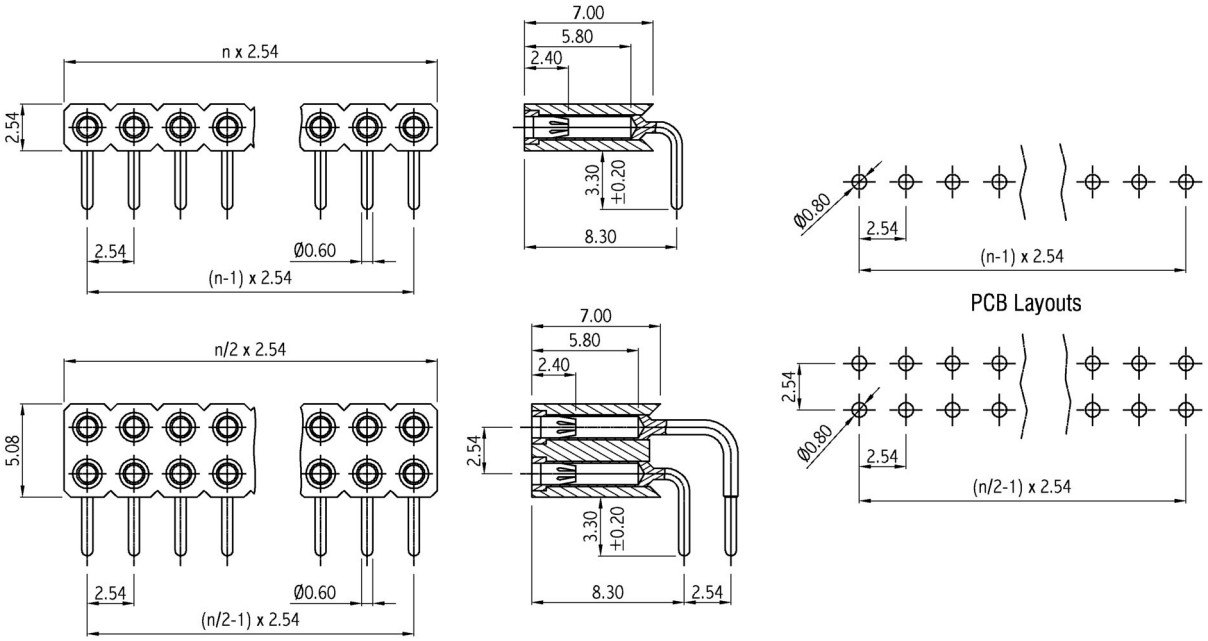
## Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig
## *Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row*

**Technische Daten / *Technical Data***

| | |
|---|---|
| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
| *Insulator* | *Thermoplastic, rated UL94 V-0* |
| Kontaktmaterial | Hülse: Messing gedreht |
| | Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer |
| *Contact Material* | *Sleeve: screw machined brass* |
| | *Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper* |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| *Contact Surface* | *Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)* |
| RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c | 6c; ohne RoHS-Ausnahme: Option -LF21 |
| *RoHS Exemptions 6a-I / 6c* | *6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption* |
| Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
| *Contact Resistance* | *< 10 mΩ* |
| Isolationswiderstand | > 1000 MΩ |
| *Insulation Resistance* | *> 1000 MΩ* |
| Spannungsfestigkeit | 1 kV RMS |
| *Withstanding Voltage* | *1 kV RMS* |
| Nennspannung | 100 V RMS / 150 V DC |
| *Voltage Rating* | *100 V RMS / 150 V DC* |
| Nennstrom | 3 A |
| *Current Rating* | *3 A* |
| Temperaturbereich | -55 °C ... +125 °C |
| *Temperature Range* | *-55 °C ... +125 °C* |
| Verarbeitung | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren |
| *Processing* | *Wave or reflow soldering* |




Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.
*Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins. Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.*




| *Series* | *Contacts** | *Rows** | *Sleeve Plating* | *Clip Plating** | *Leadfree (Optional)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **154** | **002** | **1** | **50** | **00** | **LF21** |
| | **002-050** Einreihig<br>*Single row*<br>**004-100** Zweireihig<br>*Double row* | **1** Einreihig<br>*Single row*<br>**2** Zweireihig<br>*Double row* | **50** Hülse verzinnt<br>*Tin plated sleeve* | **00** Feder vergoldet<br>*Gold plated clip*<br>**10** Feder 0,25µm Gold (Option)<br>*0.25µm gold plated clip (Option)*<br>**30** Feder 0,75µm Gold<br>*0.75µm gold plated clip*<br>**50** Feder verzinnt<br>*Tin plated clip* | **LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c<br>*On request leadfree without RoHS exemption 6c* |

Für die einreihige Variante gilt eine Verarbeitungsgarantie bis 25-polig.
*For single row headers, we guarantee processing for up to 25 contacts.*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
*please replace by your specifications.*



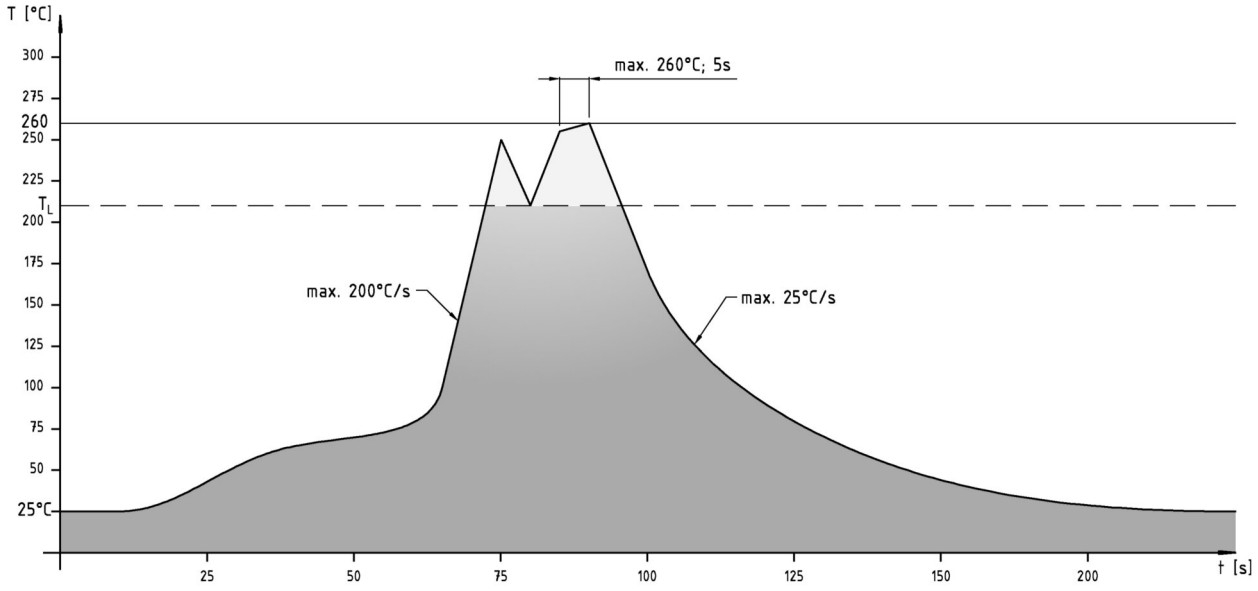
Downloaded from Arrow.com.

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren
***Wave Soldering Information***

## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

***Recommendations for Wave Soldering***

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:






Downloaded from Arrow.com.

## Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

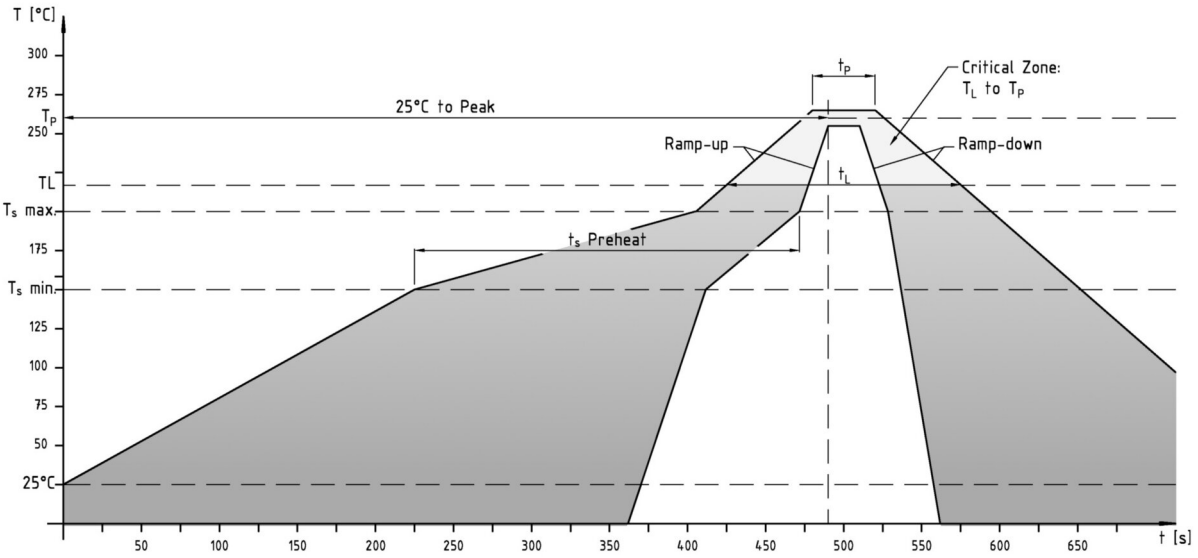
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|---|---|
| Temperatur Minimum $T_S$min | 150 °C |
| Temperatur Maximum $T_S$max | 200 °C |
| Dauer $T_S$min – $T_S$max | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich $T_L$ | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb $T_L$ | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_S$max – $T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$ | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m |

## Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

| *Profile Feature* | Key Values |
|---|---|
| *Minimum Temperature $T_S$min* | *150 °C* |
| *Maximum Temperatur $T_S$max* | *200 °C* |
| *Duration $T_S$min – $T_S$max* | *60 – 180s* |
| *Soldering Range Temperature $T_L$* | *217 °C* |
| *Duration above $T_L$* | *60 – 180s* |
| *Ramp-Up Rate $T_S$max – $T_P$* | *max. 3 °C / s* |
| *Peak Temperature $T_P$* | *260±5 °C* |
| *Duration Peak Temperature* | *20 – 40s* |
| *Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min* | *6 °C / s* |
| *Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$* | *max. 8min* |






Downloaded from Arrow.com.